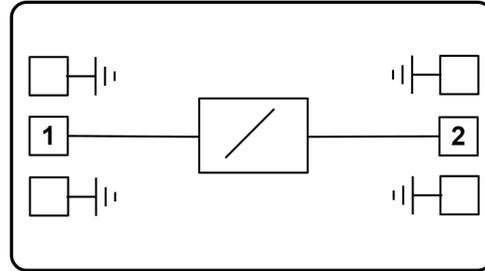




主要特点

- 频率范围: 6 - 18 GHz
- 插入损耗: 0.6 dB @ 18 GHz
- 均衡量: 8 dB
- 输入输出回波损耗: 20 dB
- 输入/输出: 50 Ohm 匹配
- 芯片尺寸: 0.85 × 1.0 × 0.1 mm³

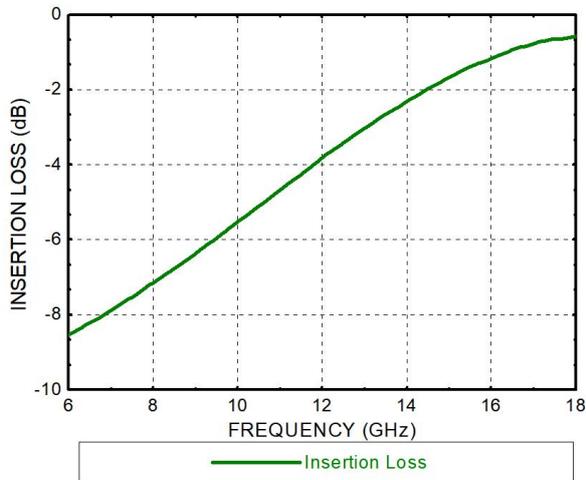
功能框图



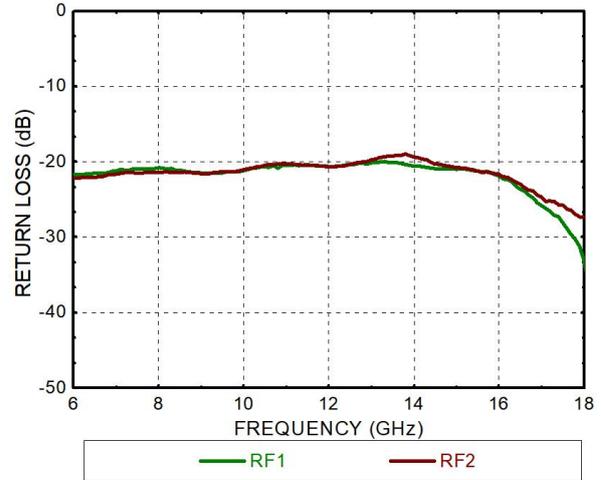
性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$)

| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|------------|--------|-----|----|-----|
| 频率范围 | 6 - 18 | | | GHz |
| 插入损耗@18GHz | | 0.6 | | dB |
| 均衡量 | | 8 | | dB |
| 回波损耗 | | 20 | | dB |

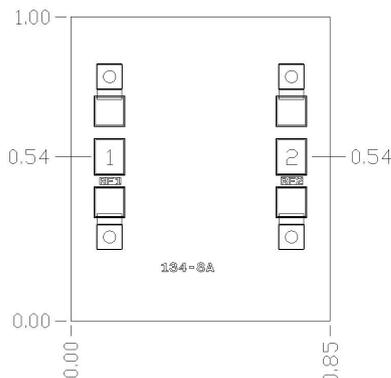
插入损耗



回波损耗



物理参数



焊盘描述

| 焊盘序号 | 功能 | 描述 |
|------|----------|--|
| 1, 2 | RF1, RF2 | 该焊盘是射频输入/输出端口, DC 耦合并匹配至 50 Ohm, 如果外部射频电压不是 0V, 那么需要外接隔直电容 |



注意事项

1. 本芯片属于静电敏感器件，运输、存储和使用过程中注意静电防护
2. 芯片厚度为 100 μm
3. 典型键合焊盘尺寸为 $120*100 \mu\text{m}^2$
4. 键合焊盘金属化：金
5. 芯片背面镀金
6. 芯片背面接地
7. 未标注的键合焊盘不需要连接
8. 钝化层信息：材质：SiN+PBO；厚度： $0.5+1.6\mu\text{m}$

极限参数

1. 射频输入功率：+30 dBm
2. 储存温度：-65 ~ +150 $^{\circ}\text{C}$
3. 工作温度：-55 ~ +85 $^{\circ}\text{C}$